

本記事は, 文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業 技術スタッフ表彰について紹介するものです.



文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム 平成 29 年度技術スタッフ表彰 優秀技術賞 原子分解能 STEM-EDS マッピングによる原子カラムの可視化 受賞者 東京大学 微細構造解析プラットフォーム 熊本 明仁氏に聞く

文部科学省ナノテクノロジープラット フォーム事業は、37の研究機関が全国の 産学官の研究者に対して、1000を超え る最先端のナノテクノロジー設備の利用 機会を提供し, イノベーションにつなが る研究成果の創出を目指している. 最先 端の研究設備の有効利用は、設備の特徴 を熟知して整備し、利用技術を高め、利 用者に使用のノウハウを提供する技術ス タッフの存在によって可能となる.この ため、ナノテクノロジープラットフォー ム (NPJ) は平成 26 年度から、特に優れ た支援を行った技術スタッフを3つの賞 (優秀技術賞,技術支援貢献賞,若手技術 奨励賞)で表彰してきた. 平成29年度 の優秀技術賞は,東京大学微細構造解析



支援に用いた電子顕微鏡の前の熊本氏と記念バッジ

プラットフォームの,同大学大学院工学系研究科総合研究機構ナノ工学研究センター主任研究員 熊本 明仁(くまもとあきひと)氏に贈られた[1].受賞テーマは「原子分解能 STEM-EDS マッピングによる原子カラムの可視化」であった.そこで,東京大学浅野キャンパスを訪ね,受賞した技術の内容,支援の状況,研究成果などを伺った.

1. 多彩な電子顕微鏡を供用する東京大 学微細構造解析プラットフォーム [2]

東京大学微細構造解析プラットフォームは,最先端電 子顕微鏡による原子構造解析や軽元素観察,多機能・高 性能X線回折装置による結晶構造解析,ナノ・二次イオ ン質量分析による高分解能微量元素分析を中心に各種の 分析手段を提供する.学内組織上は,同大学大学院工学 系研究科総合研究機構 ナノ工学研究センター・先端ナノ 計測センターとして,無機材料原子構造計測/電子状態 計測/微量元素計測/有機材料・バイオ材料構造計測/ 低炭素材料・デバイス物性構造計測の5つの計測部門を 設置することにより,基盤技術の構築や分析技術の向上 に取り組み,供用の支援を行っている.

本稿のSTEM-EDSマッピングは無機材料原子構造計測 部門の設備で行われた.この部門の主要設備は、TEM/ STEM(透過電子顕微鏡/走査透過電子顕微鏡)、SEM(走 査電子顕微鏡), FIB (集束イオンビーム装置), 試料作製 装置に大別される.東京大学において本事業で活用して いる TEM/STEM は 12 台あり,それぞれの各名称に表さ れているような特徴や用途を持っている(図1)[3].上 段右の4台は球面収差補正装置を搭載したもので,この 中の2台が熊本氏の担当となっている.



2.1 電子顕微鏡による原子配列直接観察

電子顕微鏡は、電子線を試料に入射し、試料により透過・ 散乱された電子を用いて微細な構造を拡大し観察する手 法である.光に比べて波長は著しく短いため、光学顕微 鏡の回折限界を超えた微細な構造を観察できる.電子顕 微鏡によってナノ構造が直接観察できるようになったこ



図1 東京大学 微細構造解析プラットフォーム 無機材料原子構造計測部門の透過電子顕微鏡

とにより、ナノテクノロジー研究・開発が大きく進展し ている.電子顕微鏡開発の歴史的経緯を概観すれば、ま ず試料を透過した電子線を用いて結像する透過電子顕微 鏡 (TEM, Transmission Electron Microscope) が開発され, 次いで電子線を走査し、各電子プローブ位置から放射され る二次電子を検出し、試料の表面構造を観察する走査型 電子顕微鏡(SEM, Scanning Electron Microscope)が開 発された.現在,測長 SEM は LSI 製造工程内の検査機器 として欠かせない計測手法となっている. さらに, 電子 線を走査し、試料上の各照射位置で透過・散乱された電 子を検出し,像を形成する走査型透過電子顕微鏡 (STEM, Scanning Transmission Electron Microscope) も開発され ている(図2). この手法の分解能は電子プローブのサイ ズに依存するが、電子線を集束させる電子レンズの球面 収差により、その空間分解能は長年大きく制限されてい た. これに対し、20世紀終わりに非対称磁界レンズを用 いた球面収差補正装置(Aberration corrector)が開発さ れ、原子分解能 STEM 観察が大きく進展した。その経緯 や歴史については他を参照されたい [4]. 現在, 一般的な STEM においては、試料を透過・散乱した電子線を環状明 視野(ABF, Annular Bright Field)検出器や円環状の高角 散乱暗視野(HAADF, High Angle Annular Field)検出器 で検出して,像を形成する.

上述の STEM 像からは原子位置と原子番号の大小を判 別することは可能であるが,元素種を識別することはで きない.一方,STEMの高い空間分解能を維持したまま, 電子線を照射した位置から発生する特性 X 線を図2に 示すようなシリコンドリフト検出器 (SDD, Silicon Drift Detector)により検出・分析するエネルギー分散型 X 線 分光 (EDS, Energy Dispersive X-ray Spectroscopy)を併 用することにより,原子カラム (原子列)ごとの元素分 析が可能になっている.



図 2 STEM の概略図

2.2 STEM-EDS による構造解析例

STEM-EDS による構造解析例として、熊本氏らが東京大 学の丸山教授らのグループと共同で行った垂直配向 (VA, Vertically Aligned) 単層カーボンナノチューブ (SWCNT, Single Wall Carbon Nano Tube)の合成に用いる Co-Cu 系 金属触媒粒子の構造解析を紹介する [5]. Co/Cu 金属触媒 を用いて石英基板にアルコールからの CVD (化学気相蒸 着) で SWCNT を成長させると、成長温度 800℃で直径 1nm, 650℃では 0.75nm の SWCNT が得られ, それぞれ 1.1eV, 1.25eV のバンドギャップを示した. SWCNT は直 径を小さくすることで,より大きなバンドギャップが得 られる. このことから, VA-SWCNT の構造を制御するこ とでシリコンに代わる太陽電池デバイスなどへの応用の 可能性を切り拓くものと期待されている.一般的に、良 質な結晶成長を行うために CVD での成長温度を高くする と、SWCNTの直径も著しく増大する.しかし、Co-Cu系 金属触媒粒子では、650℃から800℃までの成長温度で 直径 1nm 以下を維持しており、そのメカニズムの解明の ため STEM-EDS により触媒金属の構造解析を行った.

図3左のHAADF STEM像ではシリカ膜上に堆積した金属微粒子の分布がわかる.電子線の高角散乱は原子番号Zに強く依存し,HAADF像のコントラストは約Z²に比例する.CoとCuの原子番号Zは,27と29で近いため,HAADF像では両者の識別は難しい.しかし,図中央の,Co,Cuの特性X線の強度をそのエネルギーに対してプロッ

トした EDS スペクトルでは Co と Cu がはっきりと区別で きる.そこで、HAADF STEM 像による原子カラム観察と EDS 元素マップを重ね合わせることで、HAADF STEM 像 に元素分布情報を付与したものが図3の右図である.緑 色の領域が Cu,紫色の領域が Co に対応する.同じ fcc 構 造の金属微粒子においても Co と Cu は互いに固溶しない ため、Co と Cu は相分離しつつ共存している.Co が Cu に繋ぎ止められているため、触媒が凝集することなく、 Co 単体の触媒性能を維持していることが分かった.

このように, HAADF STEM 像だけでは元素識別が困難 な系においても, EDS と組み合わせることにより, 超高 分解能で元素マッピングを行うことが可能である.

2.3 原子分解能電子顕微鏡による軽元素原子コラ ムイメージング

HAADF 法では、Z が大きく、電子散乱能の大きい重 元素の信号が支配的であるため、重元素と軽元素が混 在する複合酸化物等では、Z の小さい炭素(C)、酸素 (O)、窒素(N)などの可視化は困難なことが多い.一方、 STEM の明視野像は、TEM と類似するコントラストが得 られ、軽元素と重元素のコントラスト差は HAADF より小 さい.そこで、ABF 法による軽元素原子直接観察法が開 発された.[6][7]

強誘電体材料のチタン酸バリウム BaTiO₃ の STEM 観察 を行うと、図4(左)に示すように HAADF 法では重い元



図3 STEM-EDS マッピングによる Co-Cu 系金属触媒微粒子の構造解析結果



素である Baと Ti が像中の輝点として観察できる.一方, ABF 法では軽い元素である O が像中の暗点として観察で きている(図4(右)). さらに, EDS における特性 X 線 検出には,従来の Si(Li) 検出器よりも検出面積の大きな SDD を用いることにより,高い検出効率を実現でき,超高 感度・高効率な X 線検出・分光が可能になった. これら の技術開発は,東京大学と日本電子により共同で進めら れ,EDS 検出器として素子面積が 100mm²の SDD を 2つ 搭載したモデルが東京大学微細構造解析プラットフォー ムに設置されている(図5).

この装置は,照射系球面収差補正装置を標準搭載し, 機械的・電気的安定度を極限まで高めることで,世界最



図 5 環境対応型超高分解能走查透過型電子顕微鏡

高レベルの分析電子顕微鏡(HAADF STEM の保証分解 能 0.10nm)を実現している. 冷陰極電界放出形電子銃 (Cold-FEG)を搭載し,最高加速電圧は 200kV である.

3.開発した技術:原子分解能分析イメージングの基礎技術[8]

優秀技術賞の対象となった原子分解能分析イメージン グの基礎技術の第一は、前節に述べた、原子分解能イメー ジングを組み合わせた STEM-EDS マッピングによる軽元 素から重元素までの全元素の可視化である.これに加え て、電子線照射による試料ダメージと像質劣化の問題を 避けるため、弱電流プローブによる走査を原子分解能で 数千から数万回積算するマッピング法を開発し、観察対 象とする物質のバリエーションを広げることができた. STEM 法では、これまで弱電流プローブの高速スキャンを 複数回行うことにより、同じ構造像として得られた信号 を重ね合わせ、平均化することで分解能や、像質を上げ る手法が用いられてきたが、これにヒントを得て、さら に EDS を組み合わせたものが本技術である.

軽元素構造は電子線照射によって構造変化を起こしや すい.構造変化を少なくしようとプローブ電流を下げる とEDSの信号が小さくなり、ノイズに埋もれてしまう. そこで電子プローブを5×5nm²の試料上で高速かつ連 続的に走査し、X線検出信号を画像ピクセルごとに蓄積 する.電子線照射時間は1分以内として電子プローブが 局所領域に長時間滞在することを避ける.また、ソフト ウェア制御により4秒以内の間隔で試料のドリフト補正 を行った.実験で取得したデータは2次元の強度分布を





図 7 AIN 単結晶の原子分解能 STEM-EDS マップ

表示するデータキューブとなる. これには結晶の単位格 子が複数含まれるため,単位格子4つで分割されたデー タキューブについて,ピクセル当たりのX線カウントを 積算することにより高S/N(信号対ノイズ比)のマップ を形成できる.

図6に、BaTiO₃に対して積算マッピングした高S/N STEM-EDSマップの取得例を示す.図左上の、約4000 回スキャンして得られたスペクトルイメージ(4Dデータ キューブ)について、同時取得したSTEM像の結晶周期 構造に基づいて64分割し(図6右上)、それらを合算さ せることで、26万回スキャンして得たことに相当する高 感度EDSデータを生成する.この高感度EDSデータから 各元素のX線ピーク分離マップを形成することにより、 金属元素のBa、Tiとともに軽元素である酸素原子カラム までも明瞭に可視化できた(図6右下).

図7は、本手法をAIN単結晶へ適用した例である. 左上に結晶構造モデルが示されているが、STEMによって得られた原子配置のイメージに、右のAlとNのEDSスペクトル情報を重ねて、緑のN格子、赤のAl格子の原子マップができる. これを重ね、左下の軽元素を含むEDSマップが出来上がる.



4.1 構造解析の対象はパワーモジュール基板

軽元素 STEM-EDS マッピングの複合材料局所構造解析 への応用例として、パワーモジュール用の絶縁基板にお ける接合機構の解明を紹介する.パワーモジュールは自 動車のモーター駆動,自然エネルギーの電力変換などに 需要と重要性が増している.この課題は,微細構造解析 プラットフォームを利用して頂いている三菱マテリアル 株式会社からの依頼であった.同社は,パワーモジュー ル用の絶縁基板として DBA (Direct Bonded Aluminum) 基板を製造販売しているが,Al/AIN/AIの積層構造の DBA 基板において,金属 AI と絶縁体となる AIN セラミック スとの接合はこの基板の信頼性を左右するキーテクノ ロジーである [9][10].図8は代表的なパワーモジュー ルの断面構造模式図で,Si IGBT (Insulated Gate Bipoar Transistor) などのパワーデバイス (図中は Si device) が, DBA 基板を介して放熱板に半田付けされ,放熱板は冷却 器に接続して構成されている.

DBA 基板は長年にわたって使われていたが、なぜパワー デバイスの発熱があっても長期にわたって良質な積層界 面が維持されるのか、その詳細なメカニズムは不明であっ た.そこで DBA 基板中の Al/AlN 界面における原子レベ ルの構造解析を行い、接合のメカニズム解明に挑戦する ことになった.



4.2 金属 / セラミック接合パワーモジュール基板 の局所構造解析

三菱マテリアルに接合プロセスを教えてもらうと,図 9に示すように,接合部にAIと共晶(Eutectic)反応を示 す添加元素(X)を導入し,AI融点より低い温度での加熱 により,AI金属とAINセラミックスとの接合部のみを溶 融して接合していた.添加元素(X)が熱拡散でAI界面 に侵入し,その領域の融点が下がって溶解する.その後, 等温凝固中に添加元素はAI中に拡散・消失し,AI/AIN 接合が形成される.接合部のみを溶解させるTransient Liquid Phase (TLP)法により良質な界面の接合が実現す る.

そこで、添加物が界面構造形成の鍵を握ると考え、どんな元素が界面にあるかを調べた.まず、できるだけ対象物を単純にしてモデル化しようと純粋な金属 Al と融点を下げるための添加物 Si を用い、650℃に加熱して単結晶 AlN 基板と接合させた.Al の融点は 660℃だが、Si を 12.5% 含む Al-Si 共晶の融点は 577℃に下がる.

作製した接合界面観察試料は、機械研磨、アルゴンイ オンミリング法により、原子分解能 STEM による観察・ 解析用試料に加工した.界面における構造解析では、界 面を電子線に対して平行(Edge-on)になるように調整し て接合部断面に沿った元素分布を検出した.

Al/AIN 接合部を原子分解能 STEM 観察すると,金属 Al でも AIN 結晶でもない特徴的な遷移構造が見つかった.

この遷移構造が安定に存在するものかどうかを確かめる ため、 接合試料を長時間アニール処理してもらい、 もう 一度 TEM 試料を作り原子分解能で STEM 観察したところ、 今度は先ほどの遷移構造が界面のほぼ全域にわたって明 瞭に観察され、この構造が安定に形成する界面構造であ ることがわかった.元素分析を行うまでは、意図的に添 加した Si がこの遷移構造中に含まれていると考えていた が、STEM-EDS マッピングを行うと全く予想外の結果が 得られた.界面の EDS の結果からは、構成元素の Al, N, Si だけでなく Mg や O が含まれていることがわかった. 発見当時は,Mg は意図的に添加していないため,不純 物である Mg がどこからやってきたのかよく分からない 悩ましい分析結果であった.しかし、三菱マテリアルは この Mg に注目し、Al 合金である A6063(日本工業規格 JISのコード番号)とAINの接合試験を行った.このAI 合金には Mg: 0.42%, Si: 0.38% が含まれる. すると規 則的な遷移構造がアニール処理なしでも観察され、意図 的に入れた Mg が優先的に界面に偏析し遷移構造を形成 することが明らかとなった.

Al 合金と AIN との接合界面の原子分解能 STEM 像(図 10 左の 2 つ)を比較すると,界面の金属(Me)原子カ ラムは HAADF 像から,軽元素(Le)原子カラムは ABF 像から判別できる.Al と N のサイトを区別できる AIN 側 と,原子カラムが現れていない Al 合金側との間に,原子 レベルで平坦な Al 合金 /AIN 界面遷移構造の存在が観察 できる.この遷移構造は図 10 右に示す 3 つの層状構造か



図 10 AI/AIN 溶融接合界面の原子分解能 STEM (左) と界面遷移 3 層構造モデル(右)

ら形成されている. 第3層 (3rd) は HAADF と ABF の双 方で原子カラムの強度の差が小さいことから, Me 原子カ ラムで構成されていると考えられる. しかし, Al, Mg, Si の原子番号は隣り合っているので STEM 像では見分け られない.

そこで、原子分解能 STEM-EDS マッピングを行ったと ころ、単原子層の Mg が界面に見出された(図 11).一方、 添加されている Si は Al 合金側に分布することがわかった. この界面偏析構造を詳しく解析するため、信号強度を高 め、分解能や画像の質を向上するとともに、前章で述べ た積算・平均化手法を適用した.STEM 像から得られる 界面構造像と EDS 分析を組み合わせたマッピングにより、 Al, N, Mg, O, Si の原子スケールの分布が明らかになった. 原材料になかった O は Al や AlN の表面にできた自然酸化 膜から取り込まれたと考えられる. Al や N の原子カラム は AlN 側の全面にあり,界面に Mg の原子カラムが見える. これに加えて O が界面に存在し, Al 側に入ったところに Si が層状に存在する.

4.3 金属 / セラミック接合形成のメカニズム

Al 合金と AlN 基板の界面には,不純物である Mg 原子 が単原子層構造を形成し,この周囲には酸素(O) 原子も 層状構造を形成しており,数原子層レベルで複雑な界面 層状構造が自己組織的に形成されている. Al 合金と AlN 基板の界面は金属とセラミックスの単純な接合よりも, 本来は不純物であった Mg と O 原子の導入により,より 安定な界面接合が実現されることが明らかとなった.



図 11 AI 合金と AIN のヘテロ界面の原子分解能 STEM-EDS マッピング



図 12 AI 合金 /AIN 基板界面の相変化モデルと反応の自由エネルギー変化

Al 合金や AlN の表面には安定なアルミニウムの自然酸 化膜ができている.しかし, Mg は Al より酸化されやすい ため,650℃の高温で Al 合金中の Mg は次のように反応 して MgO となり,界面遷移構造が形成されると考えられ る.

 $\begin{array}{l} 3Mg + 4Al_2O_3 \rightarrow 3MgAl_2O_4 + 2Al\\ MgAl_2O_4 + 3Mg \rightarrow 2Al + 4MgO \end{array}$

酸化アルミニウム膜が単純な Al₂O₃ であるとすると,こ の接合時の界面反応は,酸化物形成の自由エネルギー変 化によって説明できる(図 12).図の左から右に向かっ て接合前,溶融接合前期,溶融接合後期,接合後を示 す.接合前には,Al 合金及び AlN 表面で自然酸化膜の酸 化アルミニウムが形成されている.酸化アルミニウム膜 は,酸素分圧の低い還元的な環境下で金属 Mg と反応し, (MgAl₂O₄ を経由するか,または直接的に)より安定な MgO と金属 Al を生成し,自由エネルギーが低下する.

この結果から, DBA 基板における AI 金属と AIN セラミッ クスとの強固な接合では,金属とセラミックスの単純な 接合よりはむしろ,不純物である Mg と 0 原子がより安 定な界面遷移構造をもたらすことが明らかになった([11] [12][13][14]).



本優秀技術賞の受賞内容は,東京大学微細構造解析プ ラットフォームで開発された軽元素対応型超高分解能走 査透過型電子顕微鏡を活用して行われた.受賞者の熊本 氏は,接合のメカニズム解明というパワーモジュール基 板製造メーカーからのニーズに応え,積算マッピングを 利用した高品質画像取得技術を開発し,複合材料の局所 構造解析から新たな材料開発につながる知見を得ること に成功した.このような新しい知見の取得には,新しい 高度な測定・解析の手法が必要だった.

良い結果が出ると、それが呼び水になって新しいユー ザが訪ねて来る.しかし、呼び水となった高度な技術を 必ずしも要しない案件も多いことから、研究内容を吟味 してより適切な実験手段を提案することもあるという. 高い解析技術を持てば、全体を俯瞰して、より適切なコ ンサルティング、アドバイスができる.今後も、技術支 援者がより高い技術を開発し、その高い技術が設備利用 を促進することを期待したい.



[1] 技術スタッフ表彰 平成 29 年度 優秀技術賞 熊本 明仁(微細構造解析 PF:東京大学)「原子分解能 STEM-EDS マッピングによる原子カラムの可視化」: http://nanonet.mext.go.jp/research_support_award/ H29_Award_1.pdf

- [2] 東京大学 微細構造解析プラットフォーム (東京大学): http://nanonet.mext.go.jp/insti/u-tokyo/nc/
- [3] 東京大学 微細構造解析プラットフォーム共用設 備の一覧 TEM/STEM: http://lcnet.t.u-tokyo.ac.jp/ keisoku2.php
- [4] 幾原雄一,「透過型電子顕微鏡法の最新技術動向と将 来展望(超高分解能イメージング)」,まてりあ 第 56巻,第3号,254-259 (2017)
- [5] Kehang Cui, Akihito Kumamoto, Rong Xiang, Hua An, Benjamin Wang, Taiki Inoue, Shohei Chiashi, Yuichi Ikuhara, and Shigeo Maruyama, "Synthesis of subnanometer-diameter vertically aligned singlewalled carbon nanotubes with copper-anchored cobalt catalysts", Nanoscale, Vol. 8, Issue 3, pp. 1608-1617 (2016)
- [6] 柴田直哉,フィンドレイスコット,幾原雄一,「環状 明視野 (ABF)STEM 法の理論と応用」,顕微鏡 Vol. 46, No. 1, pp. 66-60 (2011)
- [7] S. D. Findlay, N. Shibata, H. Sawada, E. Okunishi, Y. Kondo, T. Yamamoto, & Y. Ikuhara, "Robust atomic resolution imaging of light elements using scanning transmission electron microscopy" Applied Physics Letters, Vol. 95, 191913 (2009)
- [8] 熊本明仁,柴田直哉,藤平哲也,幾原雄一,「原子分解 能分析電子顕微鏡法を用いた金属/窒化物ヘテロ界面 の原子レベル構造解析」日本結晶学会誌 Vol. 59, pp, 246-251 (2017)
- [9] 高放熱性を有する「Cu 放熱板一体型 DBA 基板」を開発, 三菱マテリアルプレスリリース, 2015 年1月28日: http://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2015/15-0128.html
- [10] DBA 基板における新規接合技術を開発,三菱マテリ アルプレスリリース,2010年10月12日:http:// www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2010/10-1012a.pdf
- [11] Mg 単原子層が金属とセラミックスの接合を強くする! 原子分解能分析電子顕微鏡で初めて見えてきた異材接合の原子メカニズム-,東京大学工学部プレスリリース,2016.03.11: https://www.t.u-tokyo.ac.jp/foe/press/setnws_20160311135808110207131725.html
- [12] 東京大学との共同研究により金属とセラミックスの接合メカニズムを解明 三菱マテリアルプレスリリース,2016.03.11: http://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/info/2016/2016-0331.html
- [13] Akihito Kumamoto, Naoya Shibata, Kei-ichiro Nayuki, Tetsuya Tohei, Nobuyuki Terasaki, Yoshiyuki Nagatomo, Toshiyuki Nagase, Kazuhiro Akiyama,

Yoshirou Kuromitsu & Yuichi Ikuhara, "Atomic structures of a liquid-phase bonded metal/nitride heterointerface", Scientific Reports Vol. 6, Article number: 22936 (2016), doi: 10.1038/srep22936, Published online: 10 March 2016

[14] 微細構造解析プラットフォーム:東京大学 平 成 27 年度 成果事例「異種材料接合基板に おける界面構造解析:http://nanonet.mext. go.jp/?action=multidatabase_action_main_ filedownload&upload_id=3351&metadata_ id=20&download_flag=1

(図は全て熊本氏から提供された)

(古寺 博)